



报告。(4) 宜兴硅谷 2026 年第一季度已经扭亏为盈。(5) 目前公司 ATE 半导体测试板业务订单饱满, 公司专注于提升自身技术能力、产品良率、准交率和整体运营管理能力, 更好地服务于现有客户, 实现可持续发展。

(6) 公司玻璃基板研发项目有序推进中, 主要集中于工艺能力研究和设备评估方面进行开发, 目前处于技术储备阶段并已成功研制出样品, 后续进展将视市场需求情况适时调整。卫星通信 PCB 业务方面, 公司目前已完成技术储备并进行小批量量产。感谢您的关注。

**2、请问 FCBGA 封装基板项目量产进度? 满产后稳态利润率能达到多少? 谢谢**

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司 FCBGA 封装基板项目市场拓展、客户认证均按计划稳步推进中, 具体业务情况请关注后续定期报告。感谢您的关注。

**3、请问: (1) 2025 年 18 层及以上 PCB 板、HDI 板的收入占比及增速? (2) 今年以来传统多层 PCB 板和柔性板的复苏进展和价格趋势? 是否也因高端产品价格上涨而出现价格上涨? 谢谢**

答: 尊敬的投资者, 您好! 广州兴森快捷电路科技有限公司以 PCB 样板快件、CSP 封装基板和 ATE 半导体测试板业务为主, 宜兴硅谷电子科技有限公司以高多层 PCB 量产业务为主, 北京兴斐电子有限公司以 HDI 板量产业务为主, 2025 年经营数据请查阅公司年报。2026 年 PCB 行业整体景气度较好, 但面临部分核心原材料短缺和涨价的影响, 阶段性影响盈利水平, 公司会根据实际情况与客户协商调整产品价格。感谢您的关注。

**4、尊敬的公司领导, 公司 2025 年报披露 IC 封装基板销售达到了 16.7 亿, 同比增长近 50%, 其中主要是 CSP 封装基板贡献, 公司已经启动新一轮投资扩产。请问, 珠海兴科项目上一轮扩产是否已经达产? 目前公司 CSP 基板的总产能是否为 5 万平/月? 新一轮扩产大概产能能提升多少? 谢谢答复!**

答: 尊敬的投资者, 您好! 珠海兴科 2025 年扩产的 1.5 万平方米/月产能处于爬坡阶段, 爬坡进展较快。目前公司 CSP 封装基板的总产能为 5

万平方米/月，公司扩产计划将视市场情况及订单情况分期建设，具体情况请关注后续相关公告。感谢您的关注。

**5、尊敬的公司领导，请问公司珠海 FCBGA 和广州 FCBGA 项目的产品定位，参数规格，应用领域和量产计划有何异同？谢谢！**

答:尊敬的投资者，您好！珠海 FCBGA 封装基板项目原计划为中试线，广州 FCBGA 封装基板项目为大批量量产线，两个工厂的产品定位、参数规格、应用领域无明显差异，仅建成时间有先后、产能规模不一样。感谢您的关注。

**6、公司目前 ABF 载板有批量订单么？**

答:尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板目前处于小批量生产阶段，不同客户进展不同，大批量量产的进度主要取决于行业需求恢复状况、客户自身的量产进展及其供应商管理策略。感谢您的关注。

**7、子公司宜兴硅谷聚焦高多层 PCB 板，但由于产品结构不佳及产能利用率不足，2025 年依然处于亏损状态，请问管理层对宜兴硅谷是否有具体的止损时间表？如果继续亏损，是否会考虑剥离或关停这部分业务？**

答:尊敬的投资者，您好！宜兴硅谷 2026 年第一季度已经扭亏为盈。公司将持续优化生产工艺、提升自身良率水平和交付能力，调整客户和产品结构，并加大力度拓展海外市场，争取进一步提升经营业绩。感谢您的关注。

**8、公司目前 fcbga 载板和 bt 载板的最新稼动率是什么水平？对比 25 年底有进一步提升吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板项目目前处于小批量生产阶段，CSP 封装基板产能利用率处于高位，公司将视市场情况及订单情况分期启动扩产。感谢您的关注。

**9、目前 fcbga 的平均出货价是多少钱/平方米？如果不方便回答的**

话方便透露目前 fcbga 载板出货的平均层数吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板的价格视产品类型有所差异，定价主要取决于产品的层数、尺寸和特殊技术要求等。目前公司具备 20 层及以下产品的量产能力。感谢您的关注。

10、公司认为自己在 BT 载板市场的竞争力与深南电路等友商相比，短板到底在哪里？

答:尊敬的投资者，您好！与国内外头部载板同行相比，公司 BT 载板业务规模较小，规模效应尚未充分显现。目前载板行业景气度显著提升，公司在手订单饱满，公司将通过扩充产能规模、提升技术能力、改善良率和交期等提升客户满意度，加强与战略客户的合作深度与广度，进一步提升公司 BT 载板业务的规模和竞争力。感谢您的关注。

11、贵司 1 季报表示“因子公司亏损预计未来无法弥补不再递延所得税”，亏损子公司是指兴森半导体吗，如果是的话否意味着 FCBGA 业务放量不及预期？另外贵司 25 年年报中提到 FCBGA 样品订单同比大幅提升，且高层板占比也在提升，但为什么 25 年广州兴森半导体的收入只有 2700 万，比 24 年 3500 万还低？是因为订单-收入确认之间存在时间差吗？

答:尊敬的投资者，您好！亏损子公司指珠海兴森半导体有限公司。2023-2025 年期间，公司 FCBGA 封装基板项目的整体经营不及预期，对公司净利润形成较大拖累。FCBGA 封装基板业务的量产订单导入需要经历工厂审核——样品导入——可靠性验证——量产订单下达等过程，同时也与行业供需关系、客户量产进展、供应商管理策略等高度相关。感谢您的关注。

12、是否有拿下国际顶尖大厂（如英伟达、AMD 等）的实质订单？

答:尊敬的投资者，您好！公司正在努力拓展海外客户，争取实现重点产品的订单突破。感谢您的关注。

13、邱总好，贵司在 mSAP、SAP 工艺上有深厚积累，据悉 800G 和

|      |   |
|------|---|
|      | <p>1. 6T 光模块 PCB 需要用到这类升级技术，请问贵司在这类产品上是处于什么进度？是送样中，小批量还是已经进入放量？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！光模块业务是公司 2026 年的工作重心之一，北京兴斐 1.6T 光模块产品板目前处于量产爬坡阶段，并在同步开展多家客户的验证导入工作。感谢您的关注。</p> <p>14、公司产品有没有向英伟达供货？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司正在努力拓展海外客户，争取实现重点产品的订单突破。感谢您的关注。</p> <p>15、尊敬的公司领导，可否披露一下 FCBGA 载板最新的可稳定量产的层数、尺寸、线宽线距和对应良率？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！目前公司具备 20 层及以下产品的量产能力，产品最小线宽线距达 9/12um，最大尺寸为 120*120mm，低层板良率超 95%，高层板良率超 90%。感谢您的关注。</p> <p>16、目前 ABF 载板良率怎么样？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板低层板良率超 95%，高层板良率超 90%。感谢您的关注。</p> <p>17、公司 pcb 业务方面在 800g 和 1.6t 光模块的 pcb 有批量出货吗，其他的 pcb 方面服务器相关 pcb 占总体 pcb 的比例是多少？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！光模块业务是公司 2026 年的工作重心之一，北京兴斐 1.6T 光模块产品板目前处于量产爬坡阶段，并在同步开展多家客户的验证导入工作。公司 PCB 产品下游应用领域包括通信、消费电子、工控、医疗、安防等行业，客户集中度低，服务器相关 PCB 业务营收占比较小。感谢您的关注。</p> |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   | 2026 年 5 月 8 日  |